

Firma Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG hat sich verpflichtet, die Umsetzung der Richtlinie 2002/95/EG/ RoHS, hier im Speziellen die Forderung nach bleifreier Lötung, bereits vor dem Stichtag 01.07.2006 zu erreichen.

Ab dem 1. Mai 2005 werden wir unsere Bauteilproduktion auf "Bleifrei" umstellen und als Lotlegierung Sn-Ag-Cu einsetzen. Interne Lötversuche haben bestätigt, dass unsere Bauteile mit den geforderten Temperaturprofilen nach IEC 61760-1 ED2 und IEC 60068-2-58 verarbeitet werden können.

Bei den SMD Bauteilen (mit Kunststoffanteilen) bitten wir Sie, im Hinblick auf die hohen Löttemperaturen von bis zu 260°C/ 10 sec. (Peak), unsere Untersuchungsergebnisse mit Ihren eigenen Lötprofilen zu überprüfen und zu validieren. Entsprechende Muster können Sie bei uns anfordern.

Produkte, die noch mit dem klassischen SnPb-Lot verlötet sind und sich als Lagerbestand oder Umlaufmenge in der Produktion befinden, werden wir nach dem FiFo-Prinzip ausliefern. Die Verpackung der "Bleifrei" Bauteile werden mit einem entsprechenden Aufkleber ("Pb" durchgestrichen oder "Lead-free") kennzeichnen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, so stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Für Ihre Unterstützung bei der Erreichung der gemeinsamen Zielsetzung, die Richtlinien zu erfüllen, bedanken wir uns schon jetzt.